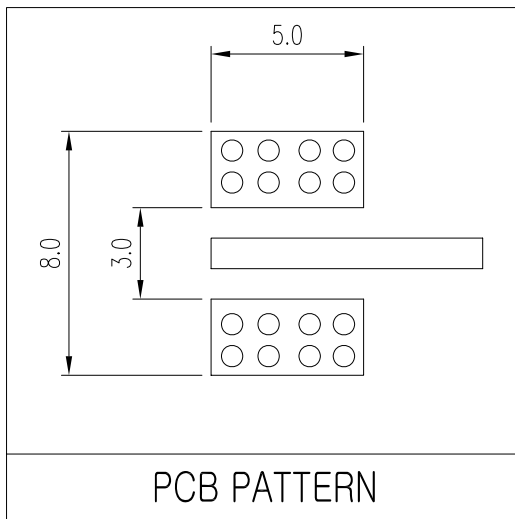
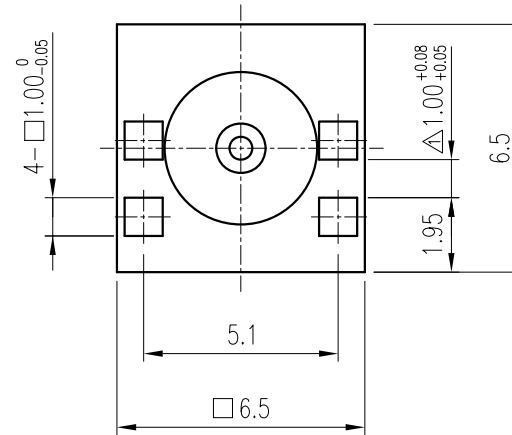
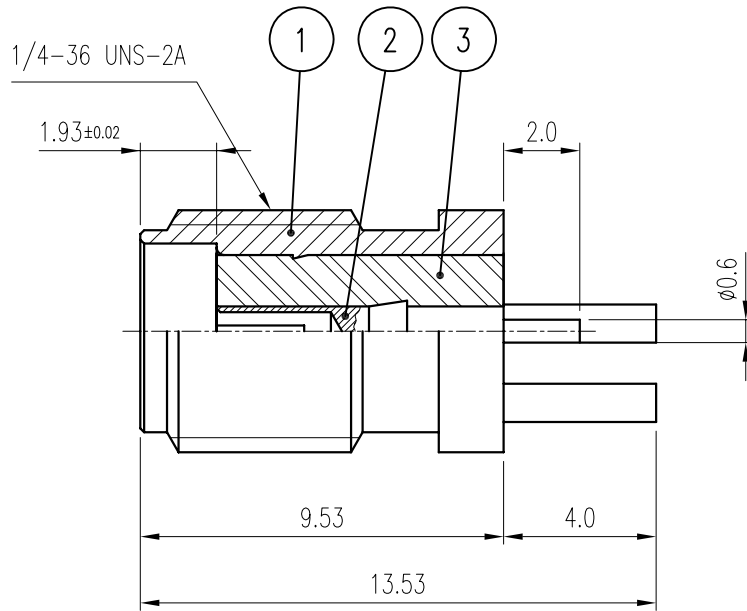


기공 ST										수 정 내 용				
									부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일	
ST(기준)									1	PCB 삽입공란(공차변경)	김은희	안병호	2004. 8. 12.	
ST(개선)									2	(첨변No.201404-012) 데프콘 플림 현상으로 인해 BODY 넘사 배는 추가	이현진	김인철	2015. 4. 29.	



△2	3	INSULATOR	1	TEFLON		H2018 (DIN00091-N/1)
	2	CONTACT	1	BeCu C17300	Gold Plate	E2422 (DCT00256-5/1)
	1	BODY	1	MBsBD C3604BD-F	Gold Plate	D2053 (DBD00309-5/1)
대체가능재질	품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차	년월일 2015. 4. 28.			 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD.		
소수 각도 분수	승인	I.C.KIM				
재질	검도			도명	SMA50 PCB JS-4R	
	제도	H.J.LEE				
열처리	작성부서 연 구 소			A4	도번 CN01444-7/1	
보호파막처리	적도 NS	단위 mm	중량		K314-479-001	



SMA50 PCB JS-4R